



平成 29 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 浅沼組
代 表 者 名 代表取締役社長 浅沼 健一
コ ー ト 番 号 1852(東証第1部)
問 合 せ 先 本社 経 理 部 長 八木 良道
電 話 番 号 06(6585)5500

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 29 年 2 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発 行 新 株 式 数	1,000,000 株
	(発行予定株式数 1,000,000 株)
2. 払 込 金 額	1 株につき 310.56 円
3. 払 込 金 額 の 総 額	310,560,000 円
4. 増 加 す る 資 本 金 の 額	155,280,000 円
5. 増 加 す る 資 本 準 備 金 の 額	155,280,000 円
6. 申 込 期 日	平成 29 年 3 月 28 日 (火)
7. 払 込 期 日	平成 29 年 3 月 29 日 (水)

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資は、平成 29 年 2 月 28 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、平成 29 年 2 月 28 日付「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び平成 29 年 3 月 8 日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

- | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|
| (1) 現在の発行済株式総数 | 84,086,293 株 | (平成 29 年 3 月 24 日現在) |
| (2) 第三者割当増資による増加株式数 | 1,000,000 株 | |
| (3) 第三者割当増資後の発行済株式総数 | 85,086,293 株 | |

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計2,374,992,000円については、1,175,000,000円を平成31年3月末までに技術研究所の試験装置の機能更新及び研究施設の増改築に係る設備投資に、590,000,000円を平成32年3月末までに工事現場の生産性向上及び業務の効率化による収益力の向上等を目的としたICT（情報通信技術）関連システム（BIM（注）、CIM（注）、原価管理システム等）の構築（システム開発及びソフトウェア、関連機器購入）に係る設備投資に、609,992,000円を平成32年3月末までに業務の効率化による経費削減を目的とした基幹システム関連（会計システム、人事給与システム、営業・工事・企画システム等）の構築（システム開発及びソフトウェア、関連機器購入）に係る設備投資の一部に、それぞれ充当する予定であります。

ご注意： この文書は、当社の第三者割当増資の結果に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

技術研究所の試験装置の機能更新については、価格競争力を強化するための工事コスト縮減に資する技術開発及びリニューアル関連工事（既存構造物や建物の改修・改築等）の受注力の強化のための、技術研究所の新規試験装置（動的載荷装置、疲労耐久試験機等）購入や最新式試験装置（3次元振動台、コンクリート圧縮試験機等）への入替え、及びソフトウェアのバージョンアップ（実建物振動測定システム等）に係る費用として、300,000,000円を平成31年3月末までに充当する予定であります。

また、研究施設の増改築については、試験装置更新に伴う間取り変更や研究ヤードの拡張等に係る費用として、875,000,000円を平成31年3月末までに充当する予定であります。

なお、基幹システム関連の構築に係る設備投資の不足額については、自己資金を充当する予定であります。

（注）BIM（ビルディング インフォメーション モデリング）は、主に建築分野においてコンピューター上に作成した3次元の建物デジタルモデルをもとに、設計、施工、維持管理までのあらゆる工程で情報を活用するための技術、CIM（コンストラクション インフォメーション モデリング）は主に土木分野におけるBIMと同様の技術を指します。

当社の設備計画の内容につきましては、平成29年2月28日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上